



## DS100KR800

### 製品概要

2012年1月

## 10.3Gbps イコライザ / デエンファシス・ドライバ内蔵 低消費電力 8 チャネル・リピータ

### 概要

DS100KR800 は、8 チャネル ( 単方向 )10G-KR やその他最大 10.3Gbps の高速通信用の超低消費電力高性能 8 チャネル・リピータです。受信イコライザ (CTLE) は 8 つそれぞれのチャネルで 5GHz で最大 +36dB のブースト (10.3125Gbps) を提供し、長いバックプレーンやケーブルなどの伝送路で生じる符号間干渉 (ISI) により閉じられた入力アイを開き、これによってホスト・コントローラはエラーのないエンド・ツー・エンドのリンクを実現できます。トランスマッタは最大 -12dB のデエンファシス・ブーストと 700mV ~ 1300mV の出力電圧振幅制御を提供し、インターフェク・チャネル内での実際の配置における柔軟性がぎわめて高くなります。

10G-KR モードでの動作時、DS100KR800 によって 802.3ap 規格の規定に従い、送信イコライザ係数の最適化を行うことで、ホスト・コントローラとエンド・ポイント間はトランスペアレントで接続できます。リンク・トレーニング・プロトコルのこのシームレスな管理により、最小レイテンシで保証済みのシステムレベルの相互運用性が実現されます。

65mW/ チャネル (typ) の低消費電力と使用しないチャネルをオフにするためのオプションにより、DS100KR800 はエネルギー効率のよいシステム設計を可能にします。デバイスの駆動には、3.3V または 2.5V の単一電源が必要です。

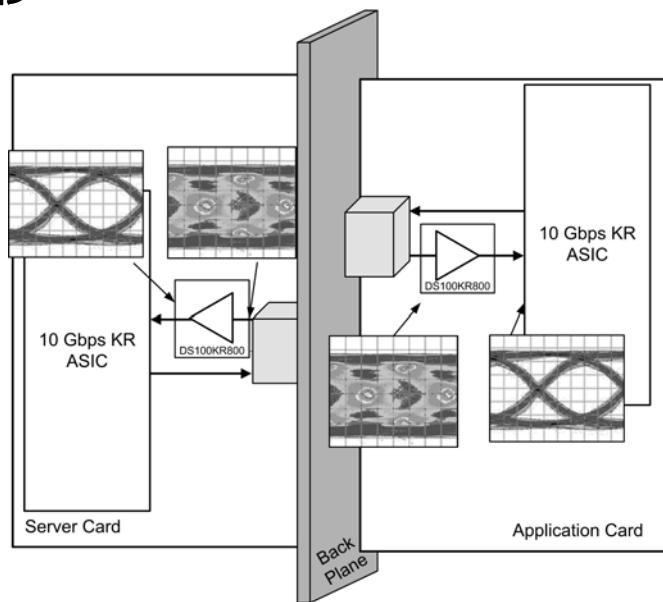
ピン設定、SMBus (I<sup>2</sup>C) プロトコルまたは外部 EEPROM を介して、設定をプログラム可能です。EEPROM モードでの動作時は、電源投入時に自動的に構成情報がロードされます。このため、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは不要です。

注意: 本書は完全なデータシートではありません。本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄りの販売代理店までお問い合わせいただぐか、  
<http://www.ti.com> をご覧ください。

### 特長

- 全体的な製品ファミリ:  
**DS100KR800:** 8 チャネル、単方向リピータ  
**DS100KR401:** 4 × レーン、双方向リピータ  
**DS100BR210:** 2 チャネル、単方向リピータ  
**DS100BR111:** 1 × レーン、双方向リピータ
- 4 × 10G-KR やその他最大 10.3Gbps のシリアル・スタンダード用の 8 チャネル、単方向リピータ
- 10G-KR (802.3ap) リンク・トレーニング・プロトコルのトランスペアレントな管理
- 使用していないチャネルをパワーダウンするためのオプション付き低消費電力 65mW/ チャネル (typ)
- 高度の信号調整機能
  - 5GHz で最大 36dB の受信イコライジング
  - 最大 -12dB の送信デエンファシス
  - 送信出力電圧制御 : 700mV ~ 1,300mV
- ピン選択、EEPROM、または SMBus インタフェースを介してプログラム可能
- 単一電源動作 : 2.5V または 3.3V
- -40° + 85°C 動作温度
- HBM ESD 耐圧 : 3kV
- 54 ピン LLP (10mm × 5.5mm) 高速信号伝送ピン配置パッケージ

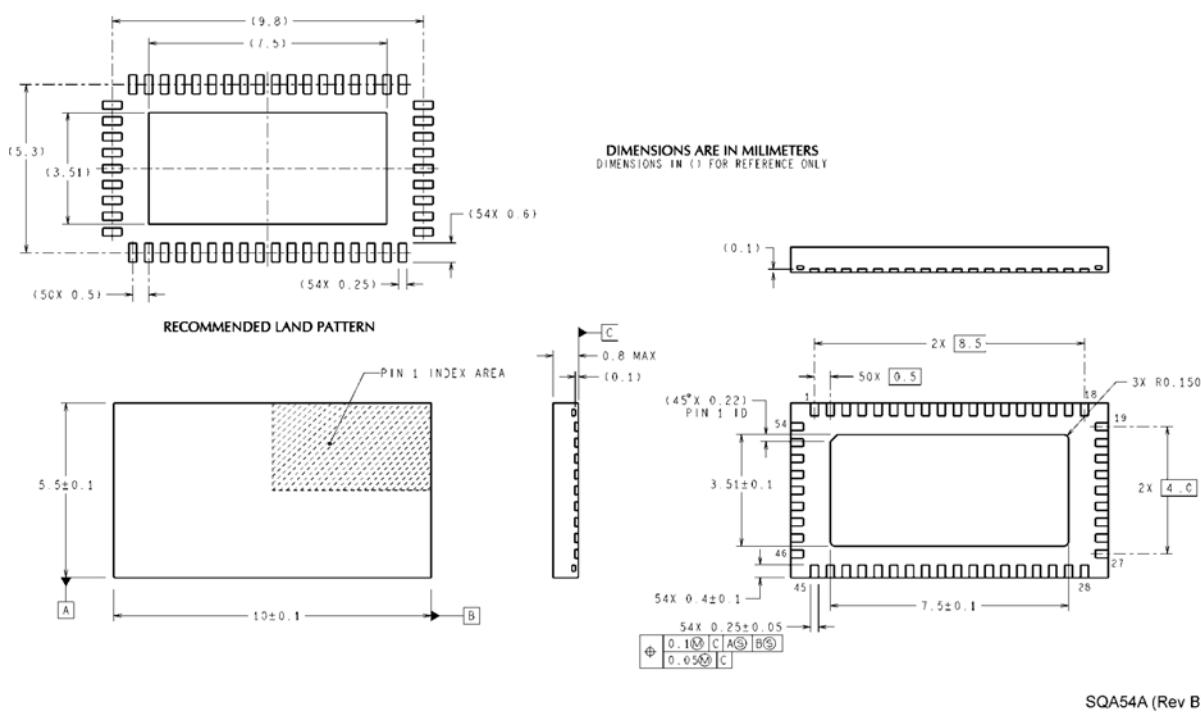
### 代表的なアプリケーション



DS100KR800 製品概要  
10.3Gbps イコライザ / デエンファシス・ドライバ内蔵  
低消費電力 8 チャネル・リピータ

DS100KR800 製品概要  
10.3Gbps イコライザ / デエンファシス・ドライバ内蔵低消費電力8チャネル・リピータ

外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)



Order Number DS100KR800SQ (Tape and Reel 2,000 units)

Order Number DS100KR800SQE (Tape and Reel 250 units)

Package Number SQA54A

すべて商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

この資料は、Texas Instruments Incorporated(TI)が英文で記述した資料を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス・インスツルメンツ(日本TI)が英文から和文へ翻訳して作成したものです。

資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補助的参考資料としてご使用下さい。

製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料をご確認下さい。

TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわらず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如何なる責任も負いません。

 **TEXAS  
INSTRUMENTS**

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
DS100KR800SQ/NOPB	Active	Production	WQFN (NJY)   54	2000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	DS100KR800SQ
DS100KR800SQ/NOPB.A	Active	Production	WQFN (NJY)   54	2000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	DS100KR800SQ
DS100KR800SQ/NOPB.B	Active	Production	WQFN (NJY)   54	2000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	DS100KR800SQ
DS100KR800SQE/NOPB	Active	Production	WQFN (NJY)   54	250   SMALL T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	DS100KR800SQ
DS100KR800SQE/NOPB.A	Active	Production	WQFN (NJY)   54	250   SMALL T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	DS100KR800SQ
DS100KR800SQE/NOPB.B	Active	Production	WQFN (NJY)   54	250   SMALL T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	DS100KR800SQ

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

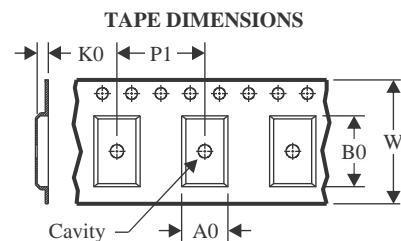
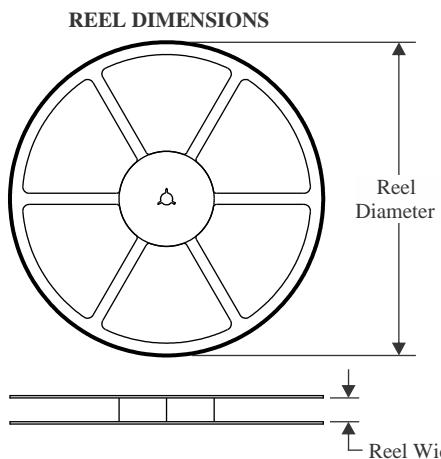
<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

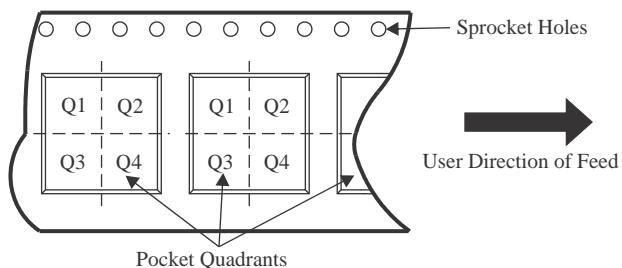
**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



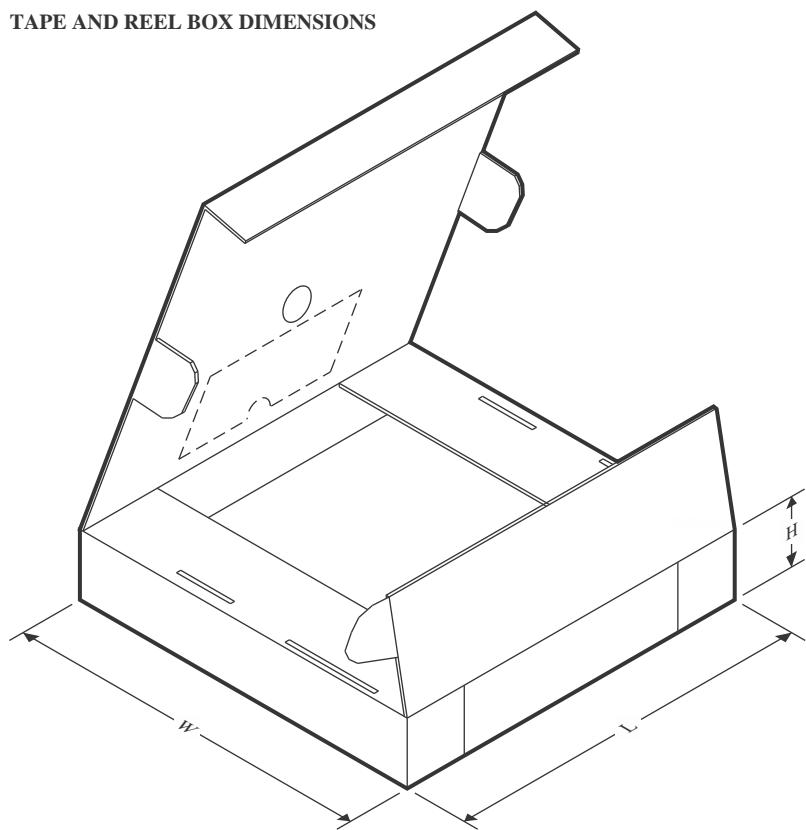
**TAPE AND REEL INFORMATION**


A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
DS100KR800SQ/NOPB	WQFN	NJY	54	2000	330.0	16.4	5.8	10.3	1.0	12.0	16.0	Q1
DS100KR800SQE/NOPB	WQFN	NJY	54	250	178.0	16.4	5.8	10.3	1.0	12.0	16.0	Q1

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


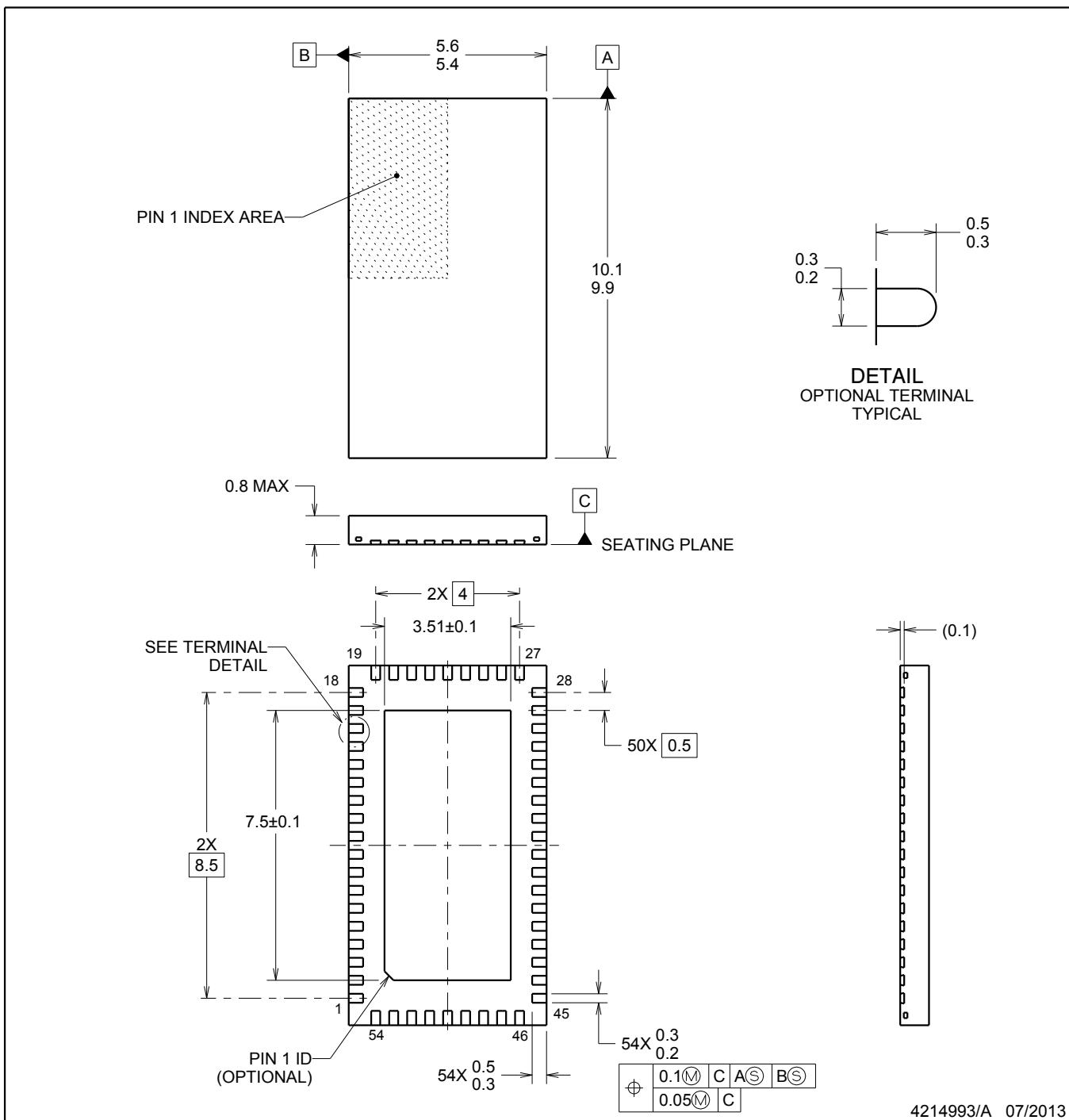
\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
DS100KR800SQ/NOPB	WQFN	NJY	54	2000	356.0	356.0	36.0
DS100KR800SQE/NOPB	WQFN	NJY	54	250	208.0	191.0	35.0

NJY0054A

WQFN

WQFN



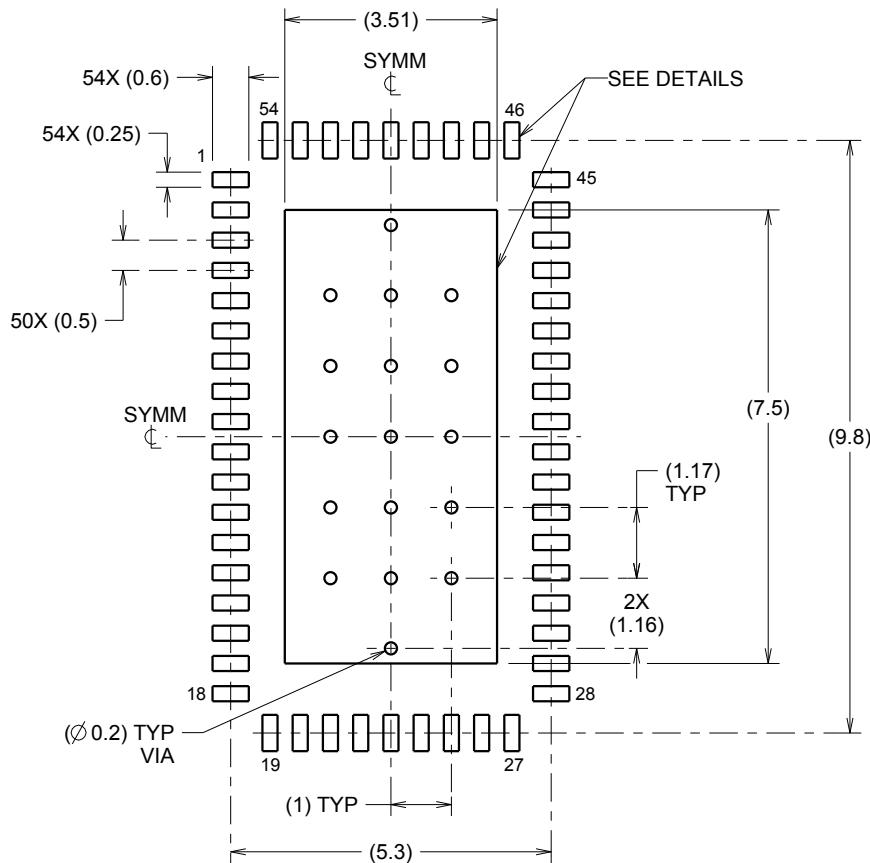
## NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

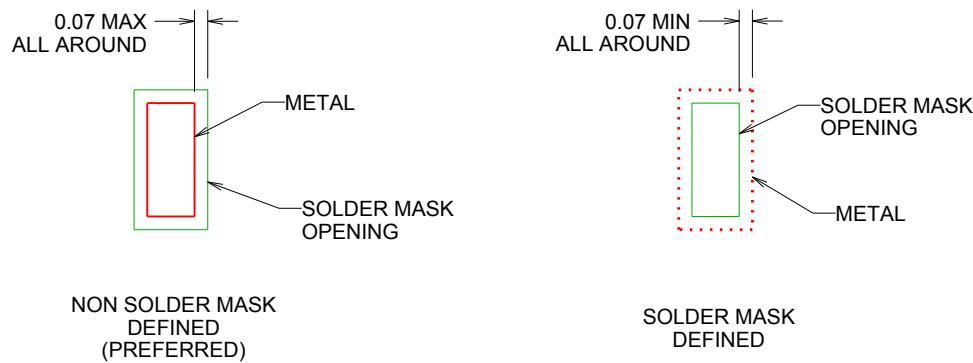
NJY0054A

WQFN

WQFN



LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214993/A 07/2013

NOTES: (continued)

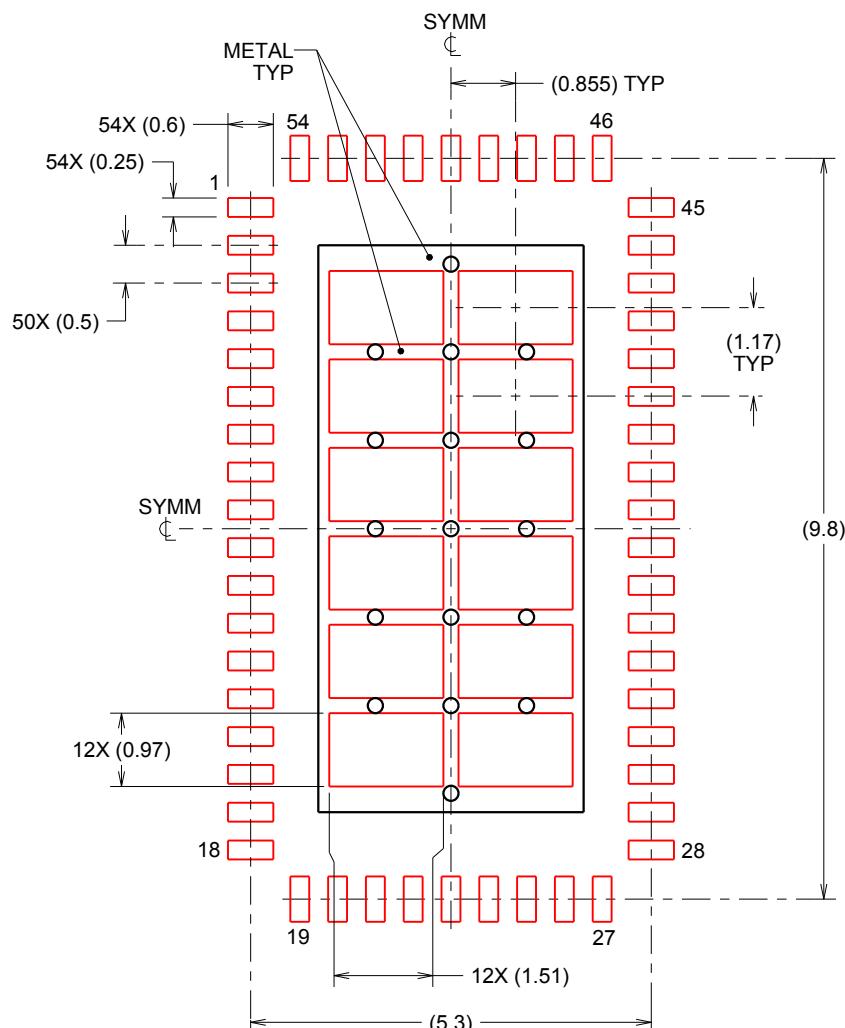
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, refer to QFN/SON PCB application note in literature No. SLUA271 ([www.ti.com/lit/slua271](http://www.ti.com/lit/slua271)).

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

NJY0054A

WQFN

WQFN



**SOLDERPASTE EXAMPLE**  
BASED ON 0.125mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD  
67% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA  
SCALE:10X

4214993/A 07/2013

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月